

川崎マイクロエレクトロニクスがジェム・デザイン社のツールを導入し、チップ-パッケージ協調設計フローを構築

2011年11月1日

株式会社ジェム・デザイン・テクノロジーズ

株式会社ジェム・デザイン・テクノロジーズ(本社：北九州市、代表取締役：村田洋、以下ジェム・デザイン)は、川崎マイクロエレクトロニクス株式会社(本社：千葉市、代表取締役社長：山内由紀夫、以下川崎マイクロ)が、ジェム・デザイン社のパッケージ フィージビリティ・スタディ (FS) ツール **GemPackage** を導入し、ASIC 開発におけるチップ-パッケージ協調設計フローを刷新したと発表しました。

川崎マイクロは、2011年4月に **GemPackage** を導入し、当初 PBGA と QFP をチップ-パッケージ協調設計の対象としていましたが、その後 FC-BGA と SiP も対象に加え、現在では同社が扱うほぼ全てのパッケージタイプを対象としています。**GemPackage** の導入と平行して ASIC 開発におけるパッケージ検討作業の業務フローを刷新したことにより、同社ではチップ開発とパッケージ開発の各部門間の連携作業の効率が従来に比べて格段に向上しました。**GemPackage** が可能にした川崎マイクロにおけるチップ-パッケージ協調設計フローの円滑化については、EDS フェア 2011Nov のセミナー(2011年11月17日 11:00 @パシフィコ横浜 アネックス F201)において、同社からの事例紹介が予定されています。

川崎マイクロエレクトロニクス社 コメント：

高木 昭彦 氏 (商品開発部パッケージ開発グループ グループ長)

「ここ数年来の信号高速化により、チップ設計とパッケージ設計それぞれを担う組織間の連携がより緊密である必要性が高まっていました。一方パッケージ技術の進歩により、パッケージ設計に必要な情報を ODM 先のパッケージメーカーに手渡すまでの検討作業が複雑化してきたことから、EDA 環境及び業務フローの改善が喫緊の課題となっていました。今回 **GemPackage** を追加導入することで、従来の設計ツールはほぼそのまま維持しつつ、仕様検討段階で小回りが利くように EDA 環境を改善することができました。**GemPackage** は柔軟なツールだったので、当社の設計フローへの組み入れや設計者間の共通ツール化が進めやすく、業務効率化に大いに役立っています。」

ジェム・デザイン社 コメント：

村田 洋 (代表取締役)

「川崎マイクロエレクトロニクスのような世界的 ASIC メーカーの仕事のお手伝いできて大変光栄です。今後末永くお付き合いいただけるように機能改善に努めてまいります。」

GemPackage について

GemPackage はジェム・デザイン社製の IC パッケージのフィージビリティスタディツールです。ラッツを曲げて配線性を検討できるスケッチアンドコンバート機能、複数階層を素通しにしてネット割り当てできる超階層設計機能などにより、チップ-パッケージ-ボード コデザインのための共通ツールとして最適です。

ジェム・デザインについて

ジェム・デザイン社は独自ツールの開発を行っている国産 EDA ベンダーです。フォーカスを絞り込み、製品を磨き、高度な職人芸をお客様に提供します。

本件に関する問い合わせ先

株式会社 ジェム・デザイン・テクノロジーズ

代表取締役 村田洋

Email: murata@gemdt.com

TEL: 093-691-0030